

■ 조세특례제한법 시행령 [별표 7] <개정 2020. 2. 11.>

신성장·원천기술의 범위(제9조제2항 관련)

| 구분         | 분야       | 대상기술                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 미래형 자동차 | 가. 자율주행차 | 1) 주행상황 인지 센서 기술: 주행상황을 인지하는 차량탐재용 비전 센서(vision sensor), 레이더 센서(radar sensor), 레이저 스캐너 센서(laser scanner sensor) 또는 초음파 센서 제작 기술과 주행환경 상의 전방위 물체에 대한 정확한 거리와 공간정보를 처리하는 소프트웨어 기술                |
|            |          | 2) 주행지능정보처리 통합시스템 기술: 차량탐재 센서 및 차량 간 통신 네트워크(network)를 기반으로 자동주차, 사고회피 및 능동안전주행을 수행하기 위한 센서퓨전(sensor fusion) 기술, 차량 내·외 통신기술과 정밀도로지도 구축 및 매칭(matching) 기술                                      |
|            |          | 3) 주행상황 인지 기반 통합제어 시스템 기술: 다양한 환경조건에서 강인하고 신뢰성 있게 차량의 정밀위치와 주변의 차량, 보행자, 차선 및 표지판 등의 주행상황을 인지하여 안정된 주행이 가능하도록 차량의 구동, 제동, 조향, 현가시스템을 능동적으로 제어하는 통합제어 시스템 설계 기술                                 |
|            |          | 4) 운전자와 자동차 간 인터페이스 및 자율주행 사고원인 규명 기술: 자율주행 환경에서 운전자의 안전성, 수용성(불안감 해소)을 향상시킬 수 있는 운전자와 자동차 간 인터페이스 설계 기술과 사고시점 전·후의 자동차 내·외부 정보를 저장하는 기술                                                       |
|            |          | 5) 운전자 인지 데이터 센서 기술: 자율주행 환경에서 안면·안구 모니터링, 심전도 등 운전자의 생체 데이터를 측정하는 센서 제조기술 및 운전자 생체 데이터 분석을 통해 운전불가 상황을 판단하여 차량을 제어하는 기술                                                                       |
|            | 나. 전기구동차 | 1) 전기구동방식 자동차의 에너지저장 시스템 밀도 향상 기술: 1회 충전 시 전기구동방식 자동차[EV(Electric Vehicle), HEV(Hybrid Electric Vehicle), PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)]의 장거리 주행거리 확보를 위한 이차전지의 에너지저장 시스템 밀도를 향상시키는 기술 |
|            |          | 2) 수소연료 저장·공급 장치 제조 기술: 수소연료로 전기를 생산하여 운행되는 수소연료전지자동차(FCEV: Fuel Cell                                                                                                                          |

|             |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             | Electric Vehicle) 내에 수소연료를 저장 및 공급하는 장치<br>제조 기술                                                                                                                                                                                  |
|             |             | 3) 수소충전소의 수소생산·압축·저장·충전설비 부품 제조<br>기술: 수소연료전지자동차에 수소연료를 공급하기 위한 수소<br>충전소의 수소 생산설비, 압축설비, 저장설비, 충전설비의 부<br>품 설계 및 제작 기술                                                                                                           |
|             |             | 4) 전기구동방식 자동차 주행효율 향상을 위한 구동계 부품·<br>모듈·시스템 개발 및 시험 기술: 전기에너지를 이용하여 차<br>량을 구동하거나 제동 시 에너지를 회수하는 부품·모듈·<br>시스템으로서 차량 구동축에 연결하거나 직접적으로 회전력<br>을 바퀴에 전달함으로써 차량을 구동시킬 수 있는 고효율<br>전동기, 동력전달장치 및 제동 시 에너지 회수가 가능한 발<br>전장치 등을 개발하는 기술 |
|             |             | 5) 대용량 충전용 전력변환장치 및 자동연결 충전 커넥터 설<br>계 및 제작기술: 최대 출력 100kW급 이상, 최대 공급 전력<br>200A 이상이고 최대 효율 92% 이상을 만족하는 전기구동<br>방식 자동차 충전용 전력변환장치와, 전기적 안전성과 사용<br>자 편리 등을 확보하기 위한 전기구동방식 자동차와 자동연<br>결되는 충전 커넥터를 설계 및 제작하는 기술                   |
|             |             | 6) 전기차 초고속·고효율 무선충전 기술: 전기구동방식 자동<br>차와 관련하여 감전위험이 없는 비접촉 무선 전력전송 방식<br>(자기유도, 자기공명, 전자기파)으로 배터리를 충전하기 위한<br>전력 전송효율 90% 이상의 초고속 고효율 무선충전시스템<br>및 무선충전 핵심모듈(급전 인버터, 집전 픽업구조, 레귤레<br>이터) 기술                                        |
| 2. 지능<br>정보 | 가. 인공<br>지능 | 1) 학습 및 추론 기술: 다양한 기계학습 알고리즘(algorithm),<br>딥러닝(deep learning), 지식베이스(knowledge base) 구축,<br>지식추론 등 학습 알고리즘과 모델링(modeling) 조합을 통해<br>지능의 정확도와 속도를 향상시키는 소프트웨어 기술                                                                  |
|             |             | 2) 언어이해 기술: 텍스트(text), 음성에서 언어를 인지, 이해하<br>고 사람처럼 응대할 수 있는 자연어 처리, 정보검색, 질의응<br>답, 언어의미 이해, 형태소·구문 분석 등 언어 관련 소프트<br>웨어 기술                                                                                                        |
|             |             | 3) <b>시각이해 기술:</b> 비디오(video), 이미지(image) 등에서 객<br>체를 구분하고 움직임의 의미를 파악하기 위한 컴퓨터 비전<br>(computer vision), 행동 인식, 내용기반 영상검색, 영상 이<br>해, 영상 생성 등 사람의 시각지능을 모사한 소프트웨어 기술                                                              |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 4) 상황이해 기술: 다양한 센서(sensor)를 통해 수집된 환경정보를 이해하거나, 대화 상대의 감정을 이해하고 주변상황과 연결한 자신의 상태를 이해하는 등 자신이 포함된 세계나 환경을 이해하여 적절한 행동을 결정짓는 소프트웨어 기술                                                                                                                  |
|                                       | 5) 인지컴퓨팅 기술: 저전력·고효율로 지능정보 학습을 수행할 수 있도록 컴퓨터 시스템 구조를 재설계하거나, 인공지능 알고리즘(algorithm) 처리가 용이하도록 초고성능 연산 플랫폼(Platform)을 제공하는 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 기술                                                                                                          |
| 나. 사물인터넷<br>(IoT: Internet of Things) | 1) IoT 네트워크 기술: 사물간의 네트워크(network)를 구성하기 위한 대량의 네트워크(Massive IoT) 구성 기술, 저전력 초경량 네트워크 기술(LPWA: Low Power Wide Area) 및 네트워크 상황에 따른 품질 보장형 협업 네트워크와 사물인터넷 전용망 기술                                                                                       |
|                                       | 2) IoT 플랫폼 기술: 다양한 사물인터넷 기기에 대한 식별·통신·검색·접근 및 사물인터넷 기기를 통한 데이터 수집·저장·관리와 데이터에 대한 분석·가공을 지원하는 지능형 소프트웨어 플랫폼(Software Platform) 기술                                                                                                                     |
|                                       | 3) 사이버물리시스템 기술: 센서와 구동체[액추에이터(Actuator)]를 갖는 기계적 장치와 이를 제어하는 정보통신 인프라(infra)를 결합하여 물리적 환경과 가상 환경을 연결하는 것으로 물리적 환경을 실시간으로 모니터링(monitoring)하여 대량의 데이터(data)를 수집·분석·처리하고 이를 바탕으로 물리적 기계장치 또는 컴퓨팅(computing) 장치를 자동으로 제어하는 임베디드(embedded) 기반 분산제어 시스템 기술 |
| 다. 클라우드<br>(Cloud)                    | 1) SaaS(Software as a Service) 기술: 다양한 클라우드 환경에서 인터넷을 통한 소프트웨어 사용이 실행가능하도록 상호운용성을 확보하고, 다양한 사용자 요구를 소프트웨어 자체의 변경없이 수용하는 맞춤형 서비스 기술 및 SaaS 응용을 연계하여 새로운 서비스를 제공하는 서비스 매쉬업(mashup) 기술                                                                  |
|                                       | 2) PaaS(Platform as a Service) 기술: 개발자가 데이터베이스(database), 웹(web), 모바일(mobile), 데이터(data) 처리 등의 소프트웨어 개발 환경을 클라우드 상에서 손쉽게 활용하여 응용 서비스의 개발·배포 및 이전이 가능하도록 하는 기술 및 실행환경 제공 기술                                                                           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 3) IaaS(Infrastructure as a Service) 기술: 가상머신(Virtual Machine) 혹은 컨테이너(container, 경량화된 가상화기술) 기반으로 자원을 가상화하고, 다중 클라우드 연동을 통해 자원을 확장하는 기술 및 다양한 클라우드 인프라 서비스의 중개를 위한 클라우드 서비스 브로커리지(Cloud Service Brokerage) 기술 |
| 라. 빅데이터<br>(Big Data) | 1) 빅데이터 수집·정제·저장 및 처리기술: 여러 입력 소스(source)에서 발생하는 다양한 종류의 대규모 데이터(data)를 수집·정제하거나, 향후 분석을 위해 고속의 저장소에 저장하고 관리하는 기술                                                                                              |
|                       | 2) 빅데이터 분석 및 예측 기술: 대규모 데이터(data)에 다양한 통계기법, 기계학습, 시뮬레이션(simulation) 기법 등을 활용하여 분석하고, 데이터에 내재한 의미를 추출하고 장단기 미래 동향을 예측하는 소프트웨어 기술                                                                               |
| 마. 착용형 스마트기기          | 1) 신체 부착형 전자회로의 유연기관 제작기술 및 유연회로 인쇄기술: 스마트 착용형기기(wearable device)에 사용되는 신체 부착형 전자회로의 유연기관 제작기술 및 유연회로 인쇄기술                                                                                                     |
|                       | 2) 유연한 양·음극 소재 및 전극 설계·제조기술: 20퍼센트 이상의 변형 시에도 기계적·전기화학적 신뢰성 확보가 가능하며 100 $\mu$ m 후박급의 착용형기기(wearable device)에 전원용으로 사용되는 유연한(flexible) 양·음극 소재 설계·제조 기술 및 해당 전극의 조성(composition)·형상(forming)의 설계·제조 기술         |
|                       | 3) 섬유기반 유연전원(fabric based flexible battery) 제조 기술: 유연 성능이 4.5g·cm <sup>2</sup> /cm 이상으로 변형에 대한 형태 안정성이 우수한 유연전원(fabric based flexible battery)으로서, 에너지 밀도가 100Wh/kg 이상으로 고효율·고수명의 성능을 가진 섬유기반 유연전원을 제조하는 기술    |
|                       | 4) 전투기능 통합형 작전용 첨단디지털 의류기술: 군사 및 경찰 작전 등의 특수 임무를 수행하는데 필요한 극한기능과 신호전송기능 및 신체보호기능을 갖춘 총체적 디지털 기능 전투복 제조 기술                                                                                                      |
|                       | 5) 생체정보 처리 및 인체내장형 컴퓨팅 기술: 생체신호 측정 및 전달 기술, 생체기능의 컴퓨터 시뮬레이션(모사) 기술, 내장형 심장 박동 기술, 인슐린 자동 분비 기술, 인공 눈/귀 등과 같이 신체의 내·외부에 장착되어 사용자의 생체정보 또는 기능을 인식·모사·처리하거나 신체의 기능을 보완·대체하는 기술                                    |
| 바. IT 융               | 1) 지능형 전자항해 기술: IMO(International Maritime                                                                                                                                                                     |

|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 합         | Organization, 국제해사기구)의 e-Navigation 구현을 목적으로 장소에 구애받지 않고 4S(ship to ship, ship to shore, shore to ship, shore to shore) 통신을 구현하는 통신단말장치 제작기술과 그 통신단말장치를 기반으로 육상과의 실시간 디지털통신을 통해 입항부터 출항까지의 항해 업무를 통합적으로 처리하고 증강현실 및 3차원 전자해도를 활용한 충돌·좌초 회피지원기능을 갖는 선박항해시스템 설계 및 구축기술                                                                                                                      |
|        |           | 2) 지능형 실시간 도시 시설물 관리시스템 기술: 도시 시설물(도로, 철도, 교량, 항만, 댐, 터널, 건축물, 전기·가스·수도 등의 공급설비, 통신시설 및 하수도시설 등)에 부착 또는 삽입하여 동 시설물들을 대상으로 통신기능 및 에너지 수확기능을 갖는 센서(sensor)를 활용하여 시설물의 운영상황 및 위험요인(물리적·기능적 결함 여부 포함)을 실시간으로 계측·평가하여 유지·보수하는 지능형 도시 시설물 관리시스템 설계·구축 기술                                                                                                                                        |
|        |           | 3) 지능형 기계 및 자율협업 기술: 생산설비에 불박이 형태(built-in)로 장착한 다양한 센서(sensor)나 엔코더(Encoder)로부터 수집한 생산설비의 품질(상태)정보 및 공정조건을 실시간으로 분석하여 최적의 작업상태를 제공할 수 있는 진단·처방정보를 창출하는 내장형·외장형 소프트웨어 제작기술과 동 정보를 바탕으로 생산설비를 원격으로 제어하는 개방형 제어기(controller), M2M(Machine to Machine, Machine to Man, 기계 간의 통신 및 인간이 작동하는 기계와의 통신) 디바이스(device) 제작기술 및 내장형·외장형 소프트웨어와 개방형 컨트롤러 디바이스를 탑재하여 자동으로 상태감시·진단·제어기능을 하는 지능형 기계 제작기술 |
|        | 사. 블록 체인  | 블록체인 기술: 모든 구성원이 분산형 네트워크(P2P Network)를 통해 정보 및 가치를 검증·저장·실행함으로써 특정인의 임의적인 조작이 어렵도록 설계된 분산 신뢰 인프라를 구현하기 위한 P2P 네트워킹기술, 합의기술, 스마트계약 검증기술, 분산저장기술, 플랫폼기술(확장성·성능 개선 등), 보안기술, IoT 기술, 적합성검증 기술                                                                                                                                                                                               |
|        | 아. 양자 컴퓨터 | 양자컴퓨터 제작 및 활용 기술: 양자 정보를 처리할 수 있는 메모리(큐비트, Qubit)를 구현하고, 큐비트간 연산처리가 가능한 장치의 제작 기술 및 양자컴퓨터의 구동·원격사용과 양자컴퓨터를 이용한 계산 등 양자컴퓨터를 활용하기 위한 기술                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. 차세대 | 가. 기반     | 1) 융합서비스·제품의 소프트웨어 내재화 기술: 서비스·제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                   |            |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대 소프트웨어 (SW) 및 보안 | 소프트웨어 (SW) | <p>품과 소프트웨어 융합화를 통해 스마트자동차, 미래형국방, 철도, 조선, 드론(drone), 맞춤형의료, 스마트패션(smart fashion, 지능형 의류 맞춤형서비스) 등 첨단 분야에서 저전력을 소비하면서 기기작동을 최적 제어하는 핵심 소프트웨어 기술 및 이러한 소프트웨어의 실시간 정확성을 검증하는 기술</p>                                       |
|                   |            | <p>2) 이기종(異機種) 멀티코어 소프트웨어 기술: 기존 CPU(Central Processing Unit) 중심의 컴퓨팅(computing) 기술에 보조연산장치, 연산 가속장치 등을 결합하여 보다 높은 성능을 제공하기 위한 고효율·고성능 소프트웨어 기술</p>                                                                     |
|                   |            | <p>3) 분산병렬 소프트웨어 기술: 하나의 대규모 연산 작업을 처리하기 위하여 네트워크에 연결되어 있는 여러 노드(node, 컴퓨터)에 작업을 나누어 동시에 처리하도록 하는 소프트웨어 기술</p>                                                                                                          |
|                   |            | <p>4) 차세대 메모리 기반 시스템 소프트웨어 기술: PC, 서버(Server), 휴대단말의 속도와 신뢰성을 획기적으로 향상시키기 위한 고성능 비휘발성 메모리(memory) 제어 소프트웨어 기술</p>                                                                                                       |
|                   |            | <p>5) 컴퓨터 이용 설계 및 공학적 분석 소프트웨어 기술: 제품 생산에 있어 개념 설계 단계 이후 제작도면 작성과 작성된 도면의 제품 성능 및 품질 검토를 수행하는 소프트웨어 기술</p>                                                                                                              |
|                   | 나. 융합 보안   | <p>1) 사이버 위협 인텔리전스(Intelligence) 대응기술: 악성코드, 지능형 지속 공격(Advanced Persistent Threat) 등 사이버 보안위협에 의해 발생하는 정보유출, 네트워크·시스템 마비, 제어권 탈취 등 금전적·사회적 손실을 방지하기 위해 지능정보기술(인공지능, 빅데이터 등)을 활용하여 사이버 공격을 사전에 자동 예측·탐지하여 분석·대응하는 기술</p> |
|                   |            | <p>2) 휴먼바이오(human-bio)·영상 기반 안전·감시·보안기술: 인간의 신체적 특성(지문, 얼굴, 홍채, 정맥 등)과 행동적 특성(서명, 음성, 걸음걸이 등)을 이용한 신원확인 기술과 영상 정보를 이용하여 사람·사물을 인식하고 추적하거나 범죄·사고 상황을 인식하는 기술</p>                                                         |
|                   |            | <p>3) 미래컴퓨팅 응용·보안기술: 대량의 데이터가 중앙에 저장되는 클라우드 컴퓨팅(cloud computing) 또는 대량의 서버(server)들이 상호 연결된 분산컴퓨팅 환경에서 감염된 시스템으로부터 내부데이터 유출을 방지하고 대용량 네트워크</p>                                                                          |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | 공격방어시스템을 제공하는 기술과 양자컴퓨팅(quantum computing) 특성에 따른 고속의 데이터·통신 암호화 및 암호해독방지 기술                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 4) 자율주행차·로봇·IoT 등 융합서비스·제품의 보안내재화 기술: 인명이나 재산상 손실을 끼칠 수 있는 실생활제품[자율주행차, 인공지능박기, 도어락(doorlock) 등]에 탑재되는 임베디드 시스템(embedded system)에 적용이 가능하도록, 기존의 보안기술에 비해 경량화 및 전력소모가 적으면서도 외부의 공격(탈취, 파괴, 위·변조 등)과 동작 과정에서 발생하는 부가정보(전력, 전자파 등)로 인해 정보가 유출·변경되는 것을 방지·대응하기 위한 기술 |
| 4. 콘텐츠 | 가. 실감형 콘텐츠 | 1) 가상현실(VR) 콘텐츠 기술: 사용자의 오감을 가상공간으로 확장·공유함으로써 환경적 제약에 의해 직접 경험하지 못하는 상황을 간접 체험할 수 있게 하는 가상현실(Virtual Reality) 콘텐츠 제작 기술                                                                                                                                           |
|        |            | 2) 증강현실(AR) 콘텐츠 기술: 디지털 콘텐츠를 현실 공간과 사물에 혼합시킴으로써 사용자에게 보다 많은 체험 서비스를 제공하게 하는 증강현실(Augmented Reality) 콘텐츠 제작 기술                                                                                                                                                     |
|        |            | 3) HD급 이상의 고품질 다시점 3D 영상 콘텐츠 제작 기술: 입체영상 시청용 안경을 착용하지 않고 입체 영상을 감상할 수 있는 무안경 디스플레이를 위한 다시점(multi-view) 콘텐츠 제작 기술                                                                                                                                                  |
|        |            | 4) 오감체험형 4D 콘텐츠 제작기술: 기존의 3D 입체영상 콘텐츠에 증강현실(Augmented Reality) 영상기술과 시각·후각·청각·미각·촉각 등의 오감체험을 통한 양방향성의 상호작용 기술이 융합된 4D 콘텐츠 제작기술                                                                                                                                    |
|        |            | 5) 디지털 홀로그램(Hologram) 콘텐츠 제작기술: 물체 형태에 대한 완벽한 3차원 정보를 조명광 파면(wavefront)의 간섭무늬 형태로 담고 있는 홀로그램 프린지(fringe) 패턴을 생성하고, 디지털화된 처리를 통하여 3차원 영상으로 재현, 편집, 정합 또는 공간인식을 하는 기술                                                                                               |
|        |            | 6) 인포콘텐츠 기술: 사용자의 실제 생활과 밀착되어 콘텐츠 소비뿐만 아니라 개인·지역·사회 전반과 관련하여 유용한 정보를 제공하는 콘텐츠 기술로, 콘텐츠 분석·검색, 소셜클라우드 협업, 실감형 고해상도 공간정보 콘텐츠 기술 등을 포함하는 기술                                                                                                                          |

|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 나. 문화 콘텐츠        |               | 1) 게임 콘텐츠 제작기술: 게임 콘텐츠의 기획·제작 및 서비스를 위한 게임엔진, 게임저작도구, 게임 UI(User Interface), 게임 운영환경, 기능성 게임 모델 개발 등의 게임 콘텐츠 기술                                                                                                                                                                                                            |
|                  |               | 2) 영상 콘텐츠 제작기술: 영화·애니메이션과 방송 등 영상 콘텐츠의 기획·제작과 서비스를 위한 스토리텔링(Storytelling), 컴퓨터 그래픽(Computer Graphic), 디지털 시네마(Digital Cinema)와 3D 입체영상 등 콘텐츠의 품질과 효율성 향상을 위한 기술                                                                                                                                                            |
|                  |               | 3) 만화·웹툰 콘텐츠 제작기술: 만화·웹툰 콘텐츠의 기획·제작 및 서비스를 위한 디지털 만화 저작도구, 만화 멀티미디어 콘텐츠 제작, 플랫폼 구축 및 서비스를 위한 저작권 보호 등 만화·웹툰 콘텐츠 기술                                                                                                                                                                                                         |
|                  |               | 4) 음악 콘텐츠 제작기술: 음악 콘텐츠의 기획·제작 및 서비스를 위한 음악 저작·편집도구, 플랫폼 구축, 음악 서비스 UI(User Interface) 등 음악 콘텐츠 기술                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. 차세대 전자 정보 바이스 | 가. 지능형 반도체·센서 | 1) 고속 컴퓨팅을 위한 SoC 설계·제조 기술: 인간형 인식, 판단, 논리를 수행할 수 있는 뉴럴넷(Neural Network)을 구현하는 초고속, 저전력 슈퍼프로세서 기술로서 지능형 자율주행 이동체(드론 등), 지능형 로봇, 게임로봇, 고속 정보 저장·처리 및 통신기기, 위성체 및 군사용 무기 체계, 보안카메라, DVR (Digital Video Recoder)등의 화상처리용 지능형 보안시스템, 복합 교통관제 시스템등의 제작을 위해 매니코어(Many Core)를 단일 반도체에 통합한 SoC(System on Chip) 설계 및 제조(10nm 이하) 기술 |
|                  |               | 2) 초소형·초저전력 IoT·웨어러블 SoC 설계·제조 기술: IoT, 착용형 스마트 단말기기 및 웨어러블 센서(wearable sensor) 등을 위해 장기간 지속사용이 가능하고, 초소형·초저전력으로 동작하며, IoT 네트워크에 지능형 서비스를 적용하기 위한 지능정보 및 데이터의 처리가 가능한 초저전력 SoC(System on Chip) 설계·제조 기술                                                                                                                    |
|                  |               | 3) SoC 파운드리 제조, 후공정 및 장비 설계·제조 기술: SoC(System on Chip) 반도체 개발·양산을 위한 핵심 기반기술로 파운드리(Foundry) 분야의 10nm 이하급 제조공정 및 공정 설계기술, 2D/2.5D/3D 패키징 등 파운드리(Foundry) 후공정 기술 및 파운드리 소재·장비 설계·제조 기술                                                                                                                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <tr> <td data-bbox="279 145 427 593"></td><td data-bbox="427 145 1385 593"> <p>4) 차세대 메모리반도체 소재·장비 및 장비부품의 설계·제조기술: 기존 메모리반도체인 D램(DRAM)과 낸드 플래시메모리(Nand Flash Memory)의 장점을 조합한 STT-MRAM(Spin Transfer Torque-Magnetic Random Access Memory), PRAM(Phase-change Random Access Memory), ReRAM(Resistive Random Access Memory) 등 차세대 메모리반도체 제조기술 및 관련 소재·장비 및 장비부품의 설계·제조기술</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="279 593 427 1093"></td><td data-bbox="427 593 1385 1093"> <p>5) 지능형 마이크로 센서 설계·제조·패키지 기술: 물리적·화학적인 아날로그(analogue) 정보를 얻는 감지부와 논리·판단·통신기능을 갖춘 지능화된 신호처리 집적회로가 결합된 소자로서 나노기술, MEMS[Micro Electro Mechanical System, 기계부품·센서(sensor)·액츄에이터(actuator) 및 전자회로를 하나의 기판 위에 집적화]] 기술, 바이오 기술, 0.8<math>\mu</math>m이하 CMOS 이미지센서 기술 또는 SoC(System on Chip) 기술이 결합된 초소형 고성능 센서 설계·제조 및 패키지 기술</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="279 1093 427 1361"></td><td data-bbox="427 1093 1385 1361"> <p>6) 차량용 반도체 설계·제조기술: 자동차 기능안전성 국제표준 ISO26262, 자동차용 반도체 신뢰성 시험규격 ACE-Q100을 만족하는 MCU(Micro controller unit), ECU(Electronic control unit), 파워IC, SOC, 하이브리드/전기차 및 자율주행용 IC 반도체의 설계·제조 기술</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="279 1361 427 1686"></td><td data-bbox="427 1361 1385 1686"> <p>7) 에너지효율향상 반도체 설계·제조기술: 실리콘 기반의 MOSFET(MOS field-effect transistor)에 비해 저저항·고효율 특성을 지니며 차세대 응용 분야(전기차, 하이브리드카, 태양광, 풍력발전 등 신재생에너지, 스마트그리드 등) 인버터 등에 탑재되는 SJ(Super Junction) MOSFET, IGBT, SiC MOSFET의 설계·제조 기술</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="279 1686 427 2150"> <p>나. 반도체 등 소재·부품</p> </td><td data-bbox="427 1686 1385 2150"> <tr> <td data-bbox="427 1686 1385 1960"></td><td data-bbox="427 1686 1385 1960"> <p>1) Photoresist 개발 및 제조기술: 반도체 및 디스플레이용 회로형성에 필요한 리소그래피(lithography)용 수지로서 회로의 내열성, 전기적 특성, 현상(Developing) 특성을 좌우하는 Photoresist 및 관련 소재를 개발 및 제조하는 기술 [ArF(불화아르곤) 광원용 및 EUV(극자외선) 광원용]</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="427 1960 1385 2150"></td><td data-bbox="427 1960 1385 2150"> <p>2) 원자층증착법(ALD, Atomic Layer Deposition) 및 화학증착법(CVD, Chemical Vapor Deposition)을 위한 고유전체(High-k dielectric)용 전구체 개발 기술: 기존의 이산화규소</p> </td></tr> </td></tr> |  | <p>4) 차세대 메모리반도체 소재·장비 및 장비부품의 설계·제조기술: 기존 메모리반도체인 D램(DRAM)과 낸드 플래시메모리(Nand Flash Memory)의 장점을 조합한 STT-MRAM(Spin Transfer Torque-Magnetic Random Access Memory), PRAM(Phase-change Random Access Memory), ReRAM(Resistive Random Access Memory) 등 차세대 메모리반도체 제조기술 및 관련 소재·장비 및 장비부품의 설계·제조기술</p> |  | <p>5) 지능형 마이크로 센서 설계·제조·패키지 기술: 물리적·화학적인 아날로그(analogue) 정보를 얻는 감지부와 논리·판단·통신기능을 갖춘 지능화된 신호처리 집적회로가 결합된 소자로서 나노기술, MEMS[Micro Electro Mechanical System, 기계부품·센서(sensor)·액츄에이터(actuator) 및 전자회로를 하나의 기판 위에 집적화]] 기술, 바이오 기술, 0.8<math>\mu</math>m이하 CMOS 이미지센서 기술 또는 SoC(System on Chip) 기술이 결합된 초소형 고성능 센서 설계·제조 및 패키지 기술</p> |  | <p>6) 차량용 반도체 설계·제조기술: 자동차 기능안전성 국제표준 ISO26262, 자동차용 반도체 신뢰성 시험규격 ACE-Q100을 만족하는 MCU(Micro controller unit), ECU(Electronic control unit), 파워IC, SOC, 하이브리드/전기차 및 자율주행용 IC 반도체의 설계·제조 기술</p> |  | <p>7) 에너지효율향상 반도체 설계·제조기술: 실리콘 기반의 MOSFET(MOS field-effect transistor)에 비해 저저항·고효율 특성을 지니며 차세대 응용 분야(전기차, 하이브리드카, 태양광, 풍력발전 등 신재생에너지, 스마트그리드 등) 인버터 등에 탑재되는 SJ(Super Junction) MOSFET, IGBT, SiC MOSFET의 설계·제조 기술</p> | <p>나. 반도체 등 소재·부품</p> | <tr> <td data-bbox="427 1686 1385 1960"></td><td data-bbox="427 1686 1385 1960"> <p>1) Photoresist 개발 및 제조기술: 반도체 및 디스플레이용 회로형성에 필요한 리소그래피(lithography)용 수지로서 회로의 내열성, 전기적 특성, 현상(Developing) 특성을 좌우하는 Photoresist 및 관련 소재를 개발 및 제조하는 기술 [ArF(불화아르곤) 광원용 및 EUV(극자외선) 광원용]</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="427 1960 1385 2150"></td><td data-bbox="427 1960 1385 2150"> <p>2) 원자층증착법(ALD, Atomic Layer Deposition) 및 화학증착법(CVD, Chemical Vapor Deposition)을 위한 고유전체(High-k dielectric)용 전구체 개발 기술: 기존의 이산화규소</p> </td></tr> |  | <p>1) Photoresist 개발 및 제조기술: 반도체 및 디스플레이용 회로형성에 필요한 리소그래피(lithography)용 수지로서 회로의 내열성, 전기적 특성, 현상(Developing) 특성을 좌우하는 Photoresist 및 관련 소재를 개발 및 제조하는 기술 [ArF(불화아르곤) 광원용 및 EUV(극자외선) 광원용]</p> |  | <p>2) 원자층증착법(ALD, Atomic Layer Deposition) 및 화학증착법(CVD, Chemical Vapor Deposition)을 위한 고유전체(High-k dielectric)용 전구체 개발 기술: 기존의 이산화규소</p> |
|                       | <p>4) 차세대 메모리반도체 소재·장비 및 장비부품의 설계·제조기술: 기존 메모리반도체인 D램(DRAM)과 낸드 플래시메모리(Nand Flash Memory)의 장점을 조합한 STT-MRAM(Spin Transfer Torque-Magnetic Random Access Memory), PRAM(Phase-change Random Access Memory), ReRAM(Resistive Random Access Memory) 등 차세대 메모리반도체 제조기술 및 관련 소재·장비 및 장비부품의 설계·제조기술</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |
|                       | <p>5) 지능형 마이크로 센서 설계·제조·패키지 기술: 물리적·화학적인 아날로그(analogue) 정보를 얻는 감지부와 논리·판단·통신기능을 갖춘 지능화된 신호처리 집적회로가 결합된 소자로서 나노기술, MEMS[Micro Electro Mechanical System, 기계부품·센서(sensor)·액츄에이터(actuator) 및 전자회로를 하나의 기판 위에 집적화]] 기술, 바이오 기술, 0.8<math>\mu</math>m이하 CMOS 이미지센서 기술 또는 SoC(System on Chip) 기술이 결합된 초소형 고성능 센서 설계·제조 및 패키지 기술</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |
|                       | <p>6) 차량용 반도체 설계·제조기술: 자동차 기능안전성 국제표준 ISO26262, 자동차용 반도체 신뢰성 시험규격 ACE-Q100을 만족하는 MCU(Micro controller unit), ECU(Electronic control unit), 파워IC, SOC, 하이브리드/전기차 및 자율주행용 IC 반도체의 설계·제조 기술</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |
|                       | <p>7) 에너지효율향상 반도체 설계·제조기술: 실리콘 기반의 MOSFET(MOS field-effect transistor)에 비해 저저항·고효율 특성을 지니며 차세대 응용 분야(전기차, 하이브리드카, 태양광, 풍력발전 등 신재생에너지, 스마트그리드 등) 인버터 등에 탑재되는 SJ(Super Junction) MOSFET, IGBT, SiC MOSFET의 설계·제조 기술</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |
| <p>나. 반도체 등 소재·부품</p> | <tr> <td data-bbox="427 1686 1385 1960"></td><td data-bbox="427 1686 1385 1960"> <p>1) Photoresist 개발 및 제조기술: 반도체 및 디스플레이용 회로형성에 필요한 리소그래피(lithography)용 수지로서 회로의 내열성, 전기적 특성, 현상(Developing) 특성을 좌우하는 Photoresist 및 관련 소재를 개발 및 제조하는 기술 [ArF(불화아르곤) 광원용 및 EUV(극자외선) 광원용]</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="427 1960 1385 2150"></td><td data-bbox="427 1960 1385 2150"> <p>2) 원자층증착법(ALD, Atomic Layer Deposition) 및 화학증착법(CVD, Chemical Vapor Deposition)을 위한 고유전체(High-k dielectric)용 전구체 개발 기술: 기존의 이산화규소</p> </td></tr>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>1) Photoresist 개발 및 제조기술: 반도체 및 디스플레이용 회로형성에 필요한 리소그래피(lithography)용 수지로서 회로의 내열성, 전기적 특성, 현상(Developing) 특성을 좌우하는 Photoresist 및 관련 소재를 개발 및 제조하는 기술 [ArF(불화아르곤) 광원용 및 EUV(극자외선) 광원용]</p>                                                                                                     |  | <p>2) 원자층증착법(ALD, Atomic Layer Deposition) 및 화학증착법(CVD, Chemical Vapor Deposition)을 위한 고유전체(High-k dielectric)용 전구체 개발 기술: 기존의 이산화규소</p>                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |
|                       | <p>1) Photoresist 개발 및 제조기술: 반도체 및 디스플레이용 회로형성에 필요한 리소그래피(lithography)용 수지로서 회로의 내열성, 전기적 특성, 현상(Developing) 특성을 좌우하는 Photoresist 및 관련 소재를 개발 및 제조하는 기술 [ArF(불화아르곤) 광원용 및 EUV(극자외선) 광원용]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |
|                       | <p>2) 원자층증착법(ALD, Atomic Layer Deposition) 및 화학증착법(CVD, Chemical Vapor Deposition)을 위한 고유전체(High-k dielectric)용 전구체 개발 기술: 기존의 이산화규소</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |

|                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | (SiO <sub>2</sub> )보다 우수한 유전특성을 갖는 high-k dielectric 박막 증착을 위한 ALD 및 CVD 공정에 사용되는 전구체를 개발하는 기술                                                                                          |
|                                                         | 3) 고순도 불화수소 개발 및 제조기술: 반도체 회로형성에 필요한 순도 99.999%(5N) 이상의 고순도 불화수소를 개발 및 제조하는 기술                                                                                                          |
|                                                         | 4) 블랭크 마스크(Blank Mask) 개발 및 제조기술: ArF(불화아르곤) 광원 및 EUV(극자외선) 광원을 이용하여 반도체 회로를 형성하는데 사용되는 블랭크마스크 원판 및 관련 소재(펠리클(Pellicle), 합성 퀴츠, 스테러링용 타겟 등을 포함)을 개발 및 제조하는 기술                           |
|                                                         | 5) 반도체용 기판 개발 및 제조기술: 15nm 이하급 D램과 150단 이상 낸드플래시메모리 및 에피텍셀 반도체용 기판을 개발 및 제조하는 기술                                                                                                        |
|                                                         | 6) 첨단 메모리반도체 장비 및 장비부품의 설계·제조 기술: 15nm 이하급 D램(DRAM)과 150단 이상 낸드 플래시메모리(Nand Flash Memory) 양산을 위한 장비·장비부품의 설계·제조 기술                                                                      |
|                                                         | 7) 플렉서블 디스플레이 패널, 차세대 차량용 디스플레이 패널용 DDI 칩(Display Driver IC) 설계 및 제조 기술: 화면에 문자나 영상 이미지 등이 표시되도록 디스플레이 패널에 구동 신호 및 데이터를 전기신호로 제공하는 반도체를 설계 및 제조하는 기술                                    |
|                                                         | 8) 고기능성 인산 제조 기술: SiN <sub>x</sub> , SiO <sub>x</sub> 막질의 선택적인 식각이 가능한 고선택비(1,000이상) 인산계 식각액 제조기술                                                                                       |
| 다. 유기 발광 다이오드 (OLED : Organic Light Emitting Diode) 등 고 | 1) 능동형 유기발광 다이오드(AMOLED: Active Matrix Organic Light Emitting Diode) 패널·부품·소재·장비 제조 기술: 대화면(9인치 이상) AMOLED 패널을 제조하기 위하여 공정별로 사용되는 기술(모듈조립공정기술은 제외한다)과 AMOLED 패널을 제조하기 위한 부품·소재·장비 제조 기술 |
|                                                         | 2) 대기압 플라즈마 식각 장비 기술: 디스플레이를 제조할 목적으로 대기압에서 플라즈마(plasma)를 발생시켜 박막을 식각하는 장비 제작기술                                                                                                         |
|                                                         | 3) 플렉서블 디스플레이 패널·부품·소재·장비 제조 기술: 플렉서블 디스플레이(유연성 또는 유연한 성질을 가지는 디스플레이로, 깨지지 않고 휘거나 말 수 있고 접을 수 있는                                                                                        |

|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 차세대 방송 통신 | 기 능 디스플레이                                          | 특성을 지닌 것을 말한다. 이하 같다)를 제조하기 위하여 공정별[유연필름 제조, 이형과 접합, TFT(Thin Film Transistor) 제조, 화소형성, 봉지, 모듈 공정 등]로 사용되는 기술과 이와 관련한 부품·소재 및 장비 제조 기술                                                                               |
|              |                                                    | 4) 차세대 차량용 디스플레이 패널·부품·소재·장비 제조 기술: 굴곡된 형상으로 제조 가능하고, 동작온도 $-30^{\circ}\text{C} \sim 95^{\circ}\text{C}$ , 시인성 black uniformity 60% 이상을 만족하는 다결정 저온 폴리실리콘(LTPS-LCD) 패널 제조기술(모듈조립공정 기술은 제외한다)과 이와 관련한 부품·소재 및 장비 제조 기술 |
|              |                                                    | 5) 마이크로 LED 디스플레이 패널·부품·소재·장비 제조 기술: 실리콘(Silicon) 또는 사파이어(Sapphire) 기판에 저결합 에피공정을 적용하여 $100\mu\text{m}$ 이하의 자발광 R/G/B 마이크로 LED 칩을 제조하는 기술과 이를 이용한 픽셀·패널 제조 기술 및 이와 관련한 부품·소재 및 장비 제조 기술                               |
|              |                                                    | 6) VR·AR·MR용 디스플레이 패널·부품·소재·장비 제조 기술: 가상현실, 증강현실, 혼합현실 기기에 사용되는 초고해상도(1,500 ppi이상) 디스플레이를 제조하기 위하여 공정별로 사용되는 기술과 이와 관련한 부품·소재 및 장비 제조기술                                                                               |
|              | 라. 3D프린팅                                           | 3D프린팅 소재·장비 개발 및 제조기술: 3차원 디지털 설계도에 따라 액체수지, 금속분말 등 다양한 형태의 재료를 적층하여 제품을 생산하는데 사용되는 소재·장비를 개발 및 제조하는 기술                                                                                                               |
|              | 마. AR 디바이스                                         | AR 디바이스 제조기술: 실제의 이미지나 배경에 유의미한 상황 정보를 기반으로 한 영상·텍스트·소리 등의 가상정보를 나타내어 사용자의 경험이 증강되고 현실세계와 동기화할 수 있는 장비 및 관련 부품의 개발 및 제조기술                                                                                             |
| 6. 차세대 방송 통신 | 가. 5세대 (5G : 5generation) 및 6세대 (6G : 6generation) | 1) 5G 이동통신 기지국 장비 기술: 가입자와 연결을 위해 이동통신사업자가 구축하는 5G 이동통신 광역 및 소형 셀(cell) 기지국 장비에 적용되는 기술                                                                                                                               |
|              |                                                    | 2) 5G 이동통신 코어네트워크(Core Network, 기간망) 기술: 트래픽(traffic) 전송·제어, 네트워크(network) 간 연결 등을 위해 5G 이동통신 기지국 장비와 연동되는 게이트웨이(gateway), 라우터(router), 스위치(switch) 등에 적용되는 기술                                                        |
|              |                                                    | 3) 5G 이동통신 단말 특화 부품 기술: 5G 이동통신 단말을                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ration<br>) 이 동<br>통신                             | 구현하기 위해 새롭게 개발·적용될 통신모듈[베이스밴드(baseband, 기저대역) 모뎀, RF(radio frequency) 칩셋(chipset) 등]의 부품·소자에 적용되는 기술                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                   | 4) 6G 이동통신 기술: 초저지연(μsec급) 기술을 기반으로 초고속(Tera bps급) 통신 지원을 위해 Tera-Hz 대역 활용을 가능하게 하는 신소자 RF·안테나 및 모뎀 및 부품·소자에 적용되는 기술                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                   | 5) 차세대 근거리 무선통신 기술: IEEE(Institute of Electrical & Electronics Engineers, 국제전기전자기술자협회) 802.11ac 규격보다 높은 주파수 효율과 전송속도를 제공하는 근거리 무선통신(무선랜: wireless LAN) 기술                                                                                                                                                                      |
|           | 나 .<br>UHD(<br>Ultra-<br>High<br>Defini-<br>tion) | 1) 지상파 UHD방송 송신기 성능 향상기술: 냉각 기술(공냉, 수냉, 질소냉각 등 포함)의 개선, 회로 설계 방식 개선 등을 통한 고효율 지상파 UHD방송용 송신기 설계·제조 기술                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                   | 2) UHD 방송 통합 다중화기 기술: 신규 전송 프로토콜[ROUTE, MMT(MPEG Media Transport) 등 포함]과 기존 전송 프로토콜[MPEG-2 TS(Transport System)]로 생성된 신호를 입력받아, 국내외 UHD 방송 표준에 따른 전송 프로토콜로 출력하는 통합형 다중화기 기술                                                                                                                                                    |
|           |                                                   | 3) 신규 방송서비스 제공을 위한 시그널링 시스템 기술: 다양한 신규 방송서비스 제공을 위하여 UHD방송 표준에 따른 시그널링(signaling) 시스템[시그널 인코더(signal encoder), 서비스가이드 인코더(service guide encoder), 시그널/서비스가이드 서버(signal/service guide server), 서비스 메타데이터(metadata) 관리서버, 통합 모니터링(monitoring) 시스템, 앱 시그널링 인코더(app signaling encoder), 콘텐츠 푸시 서버(push server, 자동제공서버) 등을 포함한다] 기술 |
| 7. 바이오·헬스 | 가. 바이오·화학물의약                                      | 1) 바이오 신약[바이오 베타(Bio Better)를 포함한다] 후보물질 발굴 기술: 유전자재조합기술, 세포배양 기술 등 새로운 생명공학을 이용하여 생명체에서 유래된 단백질·호르몬 등을 원료 및 재료로 하는 단백질의약품·유전자치료제·항체치료제·줄기세포를 이용한 세포치료제를 개발하는 기술                                                                                                                                                               |
|           |                                                   | 2) 방어 항원 스크리닝 및 제조기술: 면역 기전을 이용하여 인체질환을 방어하기 위해 항원을 스크리닝하고 이 항원을 제조하여 각종 질환을 치료하거나(치료용 백신) 예방하기 위한 백신(예방용 백신) 제조 기술                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                   | 3) 바이오시밀러 제조 및 개량기술: 바이오시밀러의 고수율                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(1g/L이상) 제조공정 기술과 서열변경, 중합체 부과, 제제변형 등의 방법으로 바이오시밀러의 활성, 안정성, 지속성을 개량하여 새로운 기능 및 효능을 부여하는 기술

4) 혁신형 신약(화합물의약품) 후보물질 발굴기술: 인체내 질병의 원인이 되는 표적 수용체(Receptor) 또는 효소(Enzyme) 등의 반응 기전(Mechanism)을 규명하고 분자설계를 통하여 표적체(Target)와 선택적으로 작용할 수 있는 구조의 화합물 후보물질 라이브러리(Library)를 확보하며, 고속탐색법(HTS, High Throughput Screening) 기술을 이용하여 후보물질 라이브러리로부터 후보물질을 도출한 후 유기합성기술을 통하여 안전성 및 유효성이 최적화된 신약 후보물질로 개발하는 기술

5) 혁신형 개량신약(화합물의약품) 개발 및 제조 기술: DDS(Drug Delivery System, 약물전달시스템), 염변경, 이성체 제조, 복합제 제조 및 바이오·나노기술과의 융합 등의 기술을 통해 기존 신약보다 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도, 편리성 등), 효능 등을 현저히 개선시킨 개량 신약을 개발·제조하는 기술

6) 임상약리시험 평가기술(임상1상 시험): 바이오 신약[바이오 베타(Bio Better)를 포함한다], 백신, 혁신형 신약(화합물의약품) 후보물질의 초기 안정성, 내약성, 약동학적, 약력학적 평가 및 약물대사와 상호작용 평가, 초기 잠재적 치료효과 추정을 위한 임상약리시험 평가기술

7) 치료적 탐색 임상평가기술(임상2상 시험): 바이오 신약[바이오 베타(Bio Better)를 포함한다], 백신, 혁신형 신약(화합물의약품) 후보물질의 용량 및 투여기간 추정 등 치료적 유용성 탐색을 위한 평가기술

8) 치료적 확증 임상평가기술(임상3상 시험): 바이오 신약[바이오 베타(Bio Better)를 포함한다], 백신, 혁신형 신약(화합물의약품) 후보물질의 안전성, 유효성 등 치료적 확증을 위한 평가기술

9) 바이오필터 소재·부품 제조기술: 바이오의약품 제조공정에서 세포, 바이러스, 단백질 등의 분리·정제·농축을 위해 사용하는 정밀여과급[MF급(Microfiltration): 평균 기공크기 0.1~10 $\mu$ m] 및 한외여과급[EF급(Microfiltration): 평균 기공크기 0.001~0.1 $\mu$ m]에 해당하는 바이오 필터 소재·부품 제조기술

|                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 나. 의료<br>기기 ·<br>헬스케어 | 1) 실시간 4D(Dimension, 차원) 초음파 영상을 위한 트랜스듀스 및 미세조직 진단기술: 초음파소자를 2차원 평면형태로 배열한 2차원 음향모듈을 이용한 것으로 가로, 세로 두개의 축 방향에 대한 자유로운 빔 조향 및 집속을 통하여 3차원 영상을 실시간으로 얻을 수 있는 초음파 진단기 기술                                      |
|                       | 2) 신체 내에서 생분해되는 소재 개발 및 제조 기술: 신체 내에서 각 부위에 적합하게 적용될 수 있는 생분해 의료용 제품[정형외과 · 치과용 임플란트(implant), 스텐트(stent), 봉합사, 약물 전달 시스템, 조직 재생 시스템]의 소재 개발 및 제조 기술                                                        |
|                       | 3) 유전자 검사용 진단기기 및 시약의 개발 및 제조 기술: 질병의 진단이나 건강상태 평가를 목적으로 인체에서 채취한 검체로부터 DNA(deoxyribonucleic acid), RNA(ribonucleic acid), 염색체, 대사물질을 추출하여 분석하는 기기 및 시약의 개발 및 제조 기술                                         |
|                       | 4) 암진단용 혈액 검사기기 및 시약의 개발 및 제조 기술: 채취한 혈액으로부터 종양 표지자의 농도를 측정하여 암발생 유무를 판단하는데 활용되는 검사기기 및 시약의 개발 및 제조 기술                                                                                                      |
|                       | 5) 감염병 병원체 검사용 진단기기 및 시약의 개발 및 제조 기술: 인체에서 채취된 혈액, 소변, 객담, 분변 등의 검체를 이용해 국내에서 새롭게 발생하였거나 발생할 우려가 있는 감염병 또는 국내 유입이 우려되는 해외 유행 감염병의 병원체를 검사하는 데 활용되는 기기 및 시약의 개발 및 제조 기술                                      |
|                       | 6) 정밀의료 등 맞춤형 건강관리 및 질병 예방 · 진단 · 치료 서비스를 위한 플랫폼 기술: 서로 다른 형태의 개인건강정보(진료기록, 일상건강정보, 유전자 분석 데이터, 공공데이터 등)를 저장 · 관리하기 위한 정보 변환기술과, 수집된 정보의 분석을 통해 질병 발병도 등 건강을 예측하고 이에 따른 맞춤형 건강관리 및 질병 예방 · 진단 · 치료를 제공하는 기술 |
| 다. 바이오<br>농수산 ·<br>식품 | 1) 비가열 전처리(pretreatment) 및 가공처리기술: 초고압(1,000기압 이상), 고압전자기장[PET(Pulsed Electric Field) 1kV 이상], 전기저항가열(Ohmic Heating), 방사선 조사(irradiation)와 같은 대체 열에너지를 사용하여 미생물 수를 감소시키거나 사멸시키는 처리기술                        |
|                       | 2) 식품용 생리활성물질 분석 및 지표물질 규명기술: 동 · 식                                                                                                                                                                         |

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | <p>물 및 미생물에서 기능성분을 추출하고 추출물에 대해 선정한 지표물질에 따라 기능성분을 분석·동정(identification)한 후 식품용도로 사용할 수 있도록 시험관 수준, 세포·동물 수준, 인체 대상으로 안전성과 기능성을 평가하는 기술</p>                                                                                                     |
|          |           | <p>3) 신식품종 종자개발기술 및 종자가공처리 기술: 유전자원을 활용하여 부분과 모본의 교배를 통하거나 전통적인 육종기술에 유전공학 기술을 접목하여 생산성, 품질, 기능성 등이 개선된 신식품종 종자를 개발하는 기술과 종자의 품질을 높이기 위한 프라이밍(priming), 코팅(coating), 펠렛팅(pelleting) 등 종자 가공처리 기술</p>                                            |
|          |           | <p>4) 유용미생물의 스크리닝 기술 및 유용물질 대량생산공정 기술: 세균이나 곰팡이를 선발·분리하여 효용성을 평가하거나 이들 미생물을 활용하여 균주개발, 발효공정, 정제공정 등을 거쳐 유용물질을 대량으로 생산하는 기술</p>                                                                                                                  |
|          |           | <p>5) 스마트팜 환경제어 기기 제작 기술: 온실이나 축사의 온도, 습도, 이산화탄소, 악취 등을 감지하여 환경을 조절하는 센서와 이를 통해 작동하는 액츄에이터(actuator) 및 제어시스템을 설계·제조하는 기술</p>                                                                                                                    |
|          |           | <p>6) 식물성단백질 분리·분획·정제 및 구조화 기술: 물리적·화학적 방법을 이용하여 농·식품자원으로부터 식물성 단백질을 전분, 지방 등과 분리하여 용도에 맞게 분획·정제하는 기술 및 식물성단백질을 3D 프린터, 압출식 성형방식 등을 통하여 구조화하는 기술</p>                                                                                            |
|          |           | <p>7) 식품 냉·해동 안정화 기술: 수분전이제어, 원물코팅, 라디오 주파수·저온 Steam 해동 등을 활용하여 냉동원료 및 제품의 품질을 균일하게 제어할 수 있는 식품 냉·해동 안정화 기술</p>                                                                                                                                 |
|          | 라. 바이오 화학 | <p>1) 바이오매스 유래 바이오플라스틱 생산 기술: 재생가능한 유기자원을 이용하여 직접 또는 전환공정을 통해 당 또는 리그닌을 추출·정제하는 기술 및 바이오플라스틱을 생산하는 기술</p> <p>2) 바이오 화장품 소재(원료) 개발 및 제조기술: 세포활성 제어기술, 미생물 발효 및 생물전환기술, 활성성분 대량생산기술 등의 바이오 기술(bio technology)을 활용하여 화장품의 소재(원료)를 개발 및 제조하는 기술</p> |
| 8. 에너지신산 | 가. 에너지저장  | <p>1) 비리튬계 이차전지 소재 등 설계 및 제조기술: 흐름전지(Flow Battery)에 사용되는 전극·멤브레인(Membrane)·전</p>                                                                                                                                                                |

|        |                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 · 환경 | 장 시스템<br>(ESS: Energy Storage System,) | 해질 · 저가 분리판 · 스택(Stack) 설계 및 제조 기술과 고온형 나트륨(Sodium)계 이차전지에 사용되는 세라믹(Ceramic) 전해질 · 셀(Cell) · 모듈(Module) 설계 및 제조 기술                                                                                                   |
|        |                                        | 2) 전력관리시스템 설계 및 전력변환장치 설계 및 제조 기술: 전력을 제어하기 위한 전력관리시스템(PMS, Power Management System) 설계 기술과 저장장치 전력과 전력계통 간의 특성을 맞춰주는 전력변환장치(PCS, Power Conversion System) 설계 및 제조 기술                                                |
|        |                                        | 3) 에너지관리시스템 기술: 주파수조정, 신재생연계, 수요반응 등의 응용 분야별 제어 소프트웨어 기술을 핵심으로 하는 에너지관리시스템(EMS, Energy Management System) 기술                                                                                                         |
|        | 나. 신재생에너지                              | 1) 실리콘 및 CIS계 박막 태양전지 고효율화 및 연속공정 기술: 비정질 및 미세결정 실리콘 박막을 이용한 2중, 3중 등 다중접합 구조의 태양전지 기술, 투명전도막 기술, 광 포획 기술, 대면적 장치 및 공정기술과 구리(Cu), 인듐(In), 셀레늄(Se) 등 화합물 증착을 이용한 CIS계 고효율화 기술(계면 저항기술, 열처리), 대면적 장치 및 연속 공정기술         |
|        |                                        | 2) 염료감응, 유기, 페로브스카이트(Perovskite) 등 태양전지 핵심소재, 대면적 모듈화 기술: 고효율화를 위한 염료, 광활성층, 전자 · 정공수송층, 광전극, 전해질, 촉매전극 재료 등의 핵심소재 제조기술, 대면적 · 고효율 · 고내구성 모듈화 기술(대면적 제조장비, 고효율 고집적 모듈기술 및 연속 공정 기술)                                  |
|        |                                        | 3) 연료전지 전용부품 제조기술: 연료전지 핵심부품인 개질기, 막전극 접합체, 금속 분리판 또는 블로어 제조 기술                                                                                                                                                      |
|        |                                        | 4) 폐기물 액화 · 가스화 기술: 폐플라스틱, 폐타이어와 같은 고분자 · 가연성 폐기물의 직 · 간접 액화 반응을 통해 연료유 또는 가스를 생산하는 기술                                                                                                                               |
|        |                                        | 5) 풍력에너지 생산 기술로서 회전동력을 증속시켜 발전기에 전달하는 부품 설계 및 제조기술: 블레이드(blade)로부터 전달되는 회전력을 전달받아 증속하여 발전기에 전달하는 장치를 구성하는 유성기어(planet carrier) · 축(shaft) · 베어링(bearing) · 이음쇠(coupling) · 브레이크(brake) 및 제어기(controller)의 설계 및 제조 기술 |
|        |                                        | 6) 풍력에너지 생산 기술로서 발전기(Generator) 및 변환기(Inverter) 제조기술: 동력 구동장치 증속기로부터 동력을 전                                                                                                                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 다. 에너지 효율 향상 | 달받아 회전자(rotor)와 고정자(stator)를 통해 전기를 발생시키는 발전기(generator)와 정속운전 유도발전기용 변환기, 가변속 운전 이중여자 유도발전기용 변환기 및 가변속 운전 동기발전기용 변환기의 설계 및 제조 기술                                                                                                                                                                                |
|              | 7) 지열 에너지 회수 및 저장 기술: 지열에너지 이용 효율 및 경제성을 향상시키는 그라우팅(grouting) 재료 제작 기술 · 보어홀(borehole) 전열저항 저감기술 · 저비용 시추기술 및 지중 축열 기술                                                                                                                                                                                           |
|              | 8) 지열발전기술: 지하 2km 이상 심도의 심부 지열자원을 개발하여 전기를 생산하기 위한 일련의 기술로서 지열자원탐사기술, 심부시추 기술, 심부시추공 조사기술, 인공 지열저류층 생성기술(enhanced geothermal system), 지열수 순환시스템 구축기술과 지열유체를 이용하여 전기를 생산하고 열 에너지를 활용하는 기술                                                                                                                         |
|              | 9) 바이오매스 유래 에너지 생산기술: 자연에 존재하는 다양한 자원을 이용하여 직접 또는 전환공정을 통하여 연료로 사용할 수 있는 고형연료, 알코올, 메탄, 디젤 등을 생산하는 기술                                                                                                                                                                                                            |
|              | 1) 지능형 전력계통(Smart Grid) 설계 및 제조기술: 전력 기술과 정보·통신 기술의 융합을 통하여 전력 공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환함으로써 고신뢰도 유지 및 에너지 효율 최적화를 달성하기 위한 차세대 전력시스템 설계 및 제조기술                                                                                                                                                                  |
|              | 2) 지능형 배전계통 고도화 및 운용기술: 지능형 배전계통에 필요한 고신뢰성·고품질의 전력공급 및 지능형 배전계통을 보호·제어하기 위한 기술로서 보호 및 제어용 지능형전력장치(IED, Intelligent Electric Device) 기술, IED가 탑재된 배전용 개폐기 및 차단기 제조 기술, 지능형 배전계통 데이터베이스(database) 통합 관리 기술, 지능형 배전계통의 자산관리 및 운용 기술, 지능형 직류배전 공급용 기기 제조 기술, 지능형 분산전원 연계기기 제조 기술, 지능형 배전계통 전력품질 보상기기 및 지능형 배전망 운용 기술 |
|              | 3) 지능형 건축물 에너지 통합 관리시스템 기술: 복수의 건축물을 대상으로 해당 건축물에서 소비하는 에너지를 원격 및 통합적으로 계측·평가 및 관리하는 통합형 건축물 군(群) 관리 시스템 설계·구축 기술                                                                                                                                                                                                |
|              | 4) 지능형 검침인프라(AMI, Advanced Metering                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Infrastructure): 양방향 통신 기반의 전자식 계량기를 활용하여 전기사용정보 등을 수집 후 통합관리하는 인프라로서 실시간으로 전력가격 및 사용정보를 소비자에게 전달하여 수요반응 등을 가능케 하고, 공급자에게는 더욱 정확한 수요 예측 및 부하관리 등이 가능하게 하는 기술

5) 웨이퍼레벨 칩 패키징 공정기술: LED 칩을 미세 패턴이 가공된 열전도성이 높은 웨이퍼 위에서 일련의 공정을 통하여 패키징한 후 다이싱(dicing)하여 칩 패키지를 제조하는 기술

6) 대형가스터빈 부품 및 시스템 설계·제작·조립·시험 평가기술: 천연가스를 연소시킬 때 발생하는 고온 고압의 에너지로 발전기를 회전시켜 전기를 생산하는 용량 100MW 이상, 효율 37% 이상의 터빈·부품 설계·제작·조립·시험 평가 기술

7) 초임계 이산화탄소 터빈구동 시스템: 열원을 활용하여 생성된 초임계상태의 이산화탄소(supercritical CO<sub>2</sub>)를 작동 유체로 터빈을 구동하는 고효율 터빈·압축기·열교환기 등 발전설비 및 시스템 개발 기술

8) 고성능 리튬이차전지 기술: 265wh/kg 이상의 에너지밀도 또는 6C-rate 이상의 방전속도를 충족하는 고성능 리튬이차전지에 사용되는 부품·소재·셀(cell) 및 모듈(module) 제조 및 안전성 향상 기술

9) 고온 연료전지(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) 소재 기술: 650℃ 이상에서 작동하는 연료전지로 다양한 연료[수소, 액화석유가스(LPG, Liquefied Petroleum Gas), 액화천연가스(LNG, Liquefied Natural Gas) 등]의 사용이 가능하고 산소이온 전도 세라믹(Oxygen ion Conducting Ceramic)을 이용하며 복합발전시스템이 가능한 전력변환장치로서 발전용 연료전지로 사용하는 소재 기술

10) 증기터빈 부품 및 시스템 설계·제작·조립·시험 평가기술: 610℃ 이상 및 270 bar 이상의 고온·고압의 에너지로 발전기를 3,600 RPM 이상으로 회전시켜 전력을 생산하는 터빈·부품설계·제작·조립·시험 평가기술

11) 선박용 디젤엔진(Diesel Engine) 제조 기술: 해상 운송의 추진, 발전용으로 사용하고, 이중연료[액화천연가스(LNG, Liquefied Natural Gas), 액화석유가스(LPG, Liquefied Petroleum Gas) 등의 가스연료 포함] 사용이 가능한 디젤

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div data-bbox="432 145 1386 360"> <p>엔진을 제조하는 기술로, 크랭크 샤프트(Crankshaft), 피스톤(Piston), 피스톤링(Piston Ring), 실린더헤드(Cylinder Head) 등 엔진의 핵심 소재·부품을 설계·제작·시험·평가하는 기술</p> </div> <div data-bbox="432 360 1386 633"> <p>12) 극저온 액체 저장 및 이송용 펌프(Pump): 액화천연가스(LNG), 액화수소가스(LH2) 등 극저온 액체를 누수 없이 저장 및 이송하기 위해 사용하는 극저온용 펌프로 극저온용 밀봉 소재와 베어링(Bearing), 터미널 헤더(Terminal Heather) 등의 부품을 설계·제조·시험·평가 기술</p> </div> <div data-bbox="432 633 1386 2150"> <div data-bbox="432 633 1386 848"> <p>1) 연소후 CO2 포집 기술: 화력발전소, 철강, 화학공정 등 화석연료 연소 후 발생하는 배기가스 중 이산화탄소를 효과적으로 분리하기 위한 흡수제, 흡착제, 분리막 등 분리소재를 제조하는 기술과 이를 이용한 이산화탄소 포집공정기술</p> </div> <div data-bbox="432 848 1386 1064"> <p>2) 연소전 CO2 포집기술: 석탄가스화 후 생성된 이산화탄소와 수소 중 이산화탄소를 분리하기 위한 흡수제, 흡착제, 분리막 등 분리소재를 제조하는 기술과 이를 이용한 이산화탄소 포집공정기술</p> </div> <div data-bbox="432 1064 1386 1444"> <p>3) 순산소 연소기술 및 저가 산소 대량 제조기술: 기존 대량 산소 제조기술인 심냉법을 대체하기 위한 이온전도성분리막(ITM, Ion Transfer Membrane), 세라믹-메탈 복합분리막(Ceramic-metal composite membrane), 흡착제 및 CLC(Chemical Looping Cycle) 등과 같이 산소를 저가로 대량생산 할 수 있는 기술과 이를 이용한 미분탄 등 화석연료의 순산소연소 공정기술</p> </div> <div data-bbox="432 1444 1386 1659"> <p>4) 이산화탄소 지중 저장소 탐사기술 및 DB(Database) 구축: 이산화탄소 포집 후 지하공간에 저장하기 위하여 다양한 탐사 기술을 이용하여 지하 저장소를 파악하고 이를 체계적으로 데이터화(위치, 저장량, 지질구조 등)하는 기술</p> </div> <div data-bbox="432 1659 1386 2058"> <p>5) 이산화탄소 수송, 저장 기술: 대량발생원에서 포집된 이산화탄소를 저장소까지 이송하기 위한 수송기술, 수송된 이산화탄소를 지하심부에 안정적으로 저장하기 위한 시추 및 주입기술, 주입된 이산화탄소의 거동을 관측하고 예측하는 기술, 이산화탄소의 누출시 지하 및 지표 생태계에 미치는 영향을 평가하고 모니터링함으로써 장기적 안정성을 제고하는 환경 영향평가 및 사후관리 기술</p> </div> <div data-bbox="432 2058 1386 2150"> <p>6) 수소응용 저온 직접환원기술: CO2 배출원단위를 감소시킬 목적으로 제철공정 중의 수소를 포집, 분리, 고순도화하는</p> </div> </div> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 공정과 합수소 원료를 이용하여 고로(Blast Furnace), 파이넥스(FINEX) 등의 제철공정에 수소를 이용하여 철광석을 환원하는 기술                                                                                                                                                                           |
|        | 7) 액화천연가스(LNG, Liquefied Natural Gas) 부유식 원유 생산저장설비(FPSO, Floating Production Storage Offloading) 및 액화천연가스 운반선(LNGC, Liquefied Natural Gas Carrier)용 압축신장기(Compander): 고부가가치선박의 액화 및 재액화 효율 향상을 위하여 LNG FPSO의 액화시스템 및 LNGC의 재액화시스템에 사용되는 냉매 압축·팽창기 제조 기술 |
|        | 8) 차세대 배기가스 규제 대응을 위한 운송·저장시스템 기술: 운송·발전용 기관을 운전할 때 배출되는 배기가스내의 질소산화물 및 배기배출물을 과급기 하류측에서 선택적촉매환원법(SCR) 등을 사용하여 저감시키는 시스템·부품의 설계·제작·시험·평가 기술                                                                                                              |
|        | 9) 제련 슬래그(Slag)를 이용한 규소철(Ferrosilicon) 및 선철(Pig Iron) 제조기술개발: 동제련 슬래그 속에 포함된 산화철(FeO), 이산화규소(SiO <sub>2</sub> )를 환원·공정 등을 통하여 제강공정에 사용 가능한 규소철(Ferrosilicon) 및 선철(Pig Iron)을 제조하는 기술                                                                     |
|        | 10) 산업 부생가스(CO, CH <sub>4</sub> ) 전환기술: 제철소, 석유화학공단, 유기성 폐기물 등에서 발생하는 부생가스(CO, CH <sub>4</sub> )를 화학·생물 전환기술을 통해 화학원료 또는 수송연료 등을 생산하는 기술                                                                                                                 |
|        | 11) 디젤 미립자 필터(DPF) 제조 기술: 디젤이 제대로 연소하지 않아 생겨나는 탄화수소 찌꺼기 등 유해물질을 모아 필터로 걸러낸 뒤 550℃ 이상의 고온으로 다시 태워 오염물질을 줄이는 저감장치의 제조 기술                                                                                                                                   |
| 마. 원자력 | 1) 원자로 냉각재 펌프(RCP, Reactor Coolant Pump) 설계 기술: 원자로에서 핵반응을 통하여 발생하는 열을 제거하여 증기발생기로 보내기 위하여 냉각재를 순환시키는 원자력발전소 핵심 기기인 원자로냉각재펌프의 상세설계기술, 원형제작기술, 성능 시험기술, 신뢰성 평가기술 등 제반 핵심 설계·제작 기술                                                                         |
|        | 2) 내열 내식성 원자력 소재 기술: 방사선, 고온 및 부식성 환경속에서 내부식성을 극대화시킬 수 있는 내열·내식성 소재(핵연료 피복관, 증기발생기 세관, 원자로 내부 구조물 등)                                                                                                                                                     |

|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | 를 개발하는 기술                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          | 3) 방사선이용 대형 공정 시스템 검사기술: 철강 배관의 손상 진단 및 미세 결함 검출을 위한 와전류 자동 검사시스템 기술, X선 발생장치와 이리듐(Ir)-192 감마선 조사장치에 적합한 이동용 방사선투시 기술                                                                                                                                                                                                                |
|           |          | 4) 신형원전(Advanced Power Reactor) 표준설계 기술: 노심 및 핵연료 설계기술, 핵증기공급계통(NSSS, Nuclear Steam Supply System) 설계기술, 주기기 설계기술, 보조기기 및 플랜트종합(BOP, Balance of Plant) 설계기술, 원전제어계통(MMIS, Man-Machine Interface System) 설계기술, 안전성분석기술 등 APR+(Advanced Power Reactor Plus) 및 SMART(System-integrated Modular Advanced Reactor)의 표준설계기술 및 표준설계인가 획득 기술 |
|           |          | 5) 가압경수형원전(Pressurized Water Reactor) 원전설계 핵심코드 개발 기술: 원자력발전소 독자개발 및 수출에 필수적인 핵심원천기술인 고유 노심설계코드(원자로 노심의 핵연료 배치 및 장전량을 결정하고 노심의 물리적 특성을 분석하는데 사용되는 핵설계코드, 열수력설계코드, 핵연료설계코드 등의 전산프로그램)와 고유 안전해석코드(원전에서 발생 가능한 모든 사고를 분석하고 원전의 안전성을 확인하는데 사용되는 계통안전해석코드, 격납건물해석코드, 중대사고해석코드 등의 전산프로그램) 개발기술                                             |
|           |          | 6) 친환경 원전해체 기술: 사용연한이 지난 원전을 영구적으로 정지한 후, 자연 상태로 되돌리기 위한 해체 공정설계, 사용후핵연료 반출 및 안전관리, 계통제염, 원자로 및 건물·설비 철거, 방사성폐기물 처리·처분 및 부지복원 기술                                                                                                                                                                                                     |
|           |          | 7) 가동원전 계측제어설비 디지털 업그레이드 기술: 가동원전 계측제어 설비의 안전성 및 신뢰성 강화를 위하여 최신기술 기준과 운전경험을 반영한 공통유형고장대응 안전 계통·제어기기 개발, 단일고장에 의한 발전소 정지 유발 요소제거, 심층방어 및 다양성 적용, 사이버보안 및 보안성 환경 적용, 가동원전 시뮬레이터를 이용한 설계 및 검증설비 구축, 노후화된 발전소의 신호선 및 케이블 식별 등 계측제어설비 디지털 업그레이드 기술                                                                                        |
| 9. 융복합 소재 | 가. 고기능섬유 | 1) 탄소섬유복합재의 가공장비 및 검사장비 설계·제조기술: 탄소섬유복합재 부품가공을 위한 복합 가공장비[관련되는 공구, 부품 고정을 위한 유연지그, 공정 모니터링 센서모듈                                                                                                                                                                                                                                      |

및 컴퓨터 수치제어기(CNC, Computerized Numerical Controller) 등을 포함한다] 설계·제조기술 및 탄소섬유복합재 가공 품질 검사를 위한 검사장비 설계·제조기술

2) 극한성능 섬유 제조 기술: 고탄성·고강도 탄소섬유 또는 섬유용 CNT(Carbon Nano Tube, 탄소나노튜브)의 제조 기술과 고탄성·고강도·고내열성(250℃ 이상)·고내한성(-153℃~-273℃) 아라미드(Aramid)·초고분자량폴리에틸렌(UHMWPE)·액정섬유의 제조 기술 및 이들의 복합화 설계를 통한 초경량·고탄성·고강도·고내열(한)성 섬유복합체 제조 기술

3) 고성능 부직포 제조 및 활용기술: 장방향의 강도와 횡방향의 강력비가 0.95 이상이고, 1.05 이하인 폴리에스테르 스펀본드(Polyester Spun-bond) 부직포의 제조 및 활용 기술

4) 막소재 및 막모듈 기술: 분리막과 막모듈을 이용하여 해수, 지표수 또는 하폐수 내에 존재하는 세균, 바이러스, 원생동물 등을 포함하는 유기물 및 입자성 탁질 물질을 제거하는 수처리 기술로서 가압형 중공사막 모듈의 경우 순수투수량은 100kPa 압력과 25℃ 온도에서 250LMH(Liter per m<sup>2</sup> hr) 이상, 기공크기는 0.05μm 이하, 파단인장강도는 9MPa 이상을 만족하며, 침지형 중공사막 모듈의 경우 순수 투수량은 음압 50kPa 압력과 25℃ 온도에서 300LMH(Liter per m<sup>2</sup> hr) 이상, 기공크기는 0.05μm 이하, 파단인장강도는 25MPa 이상을 만족하는 분리막 및 막모듈 제조 기술

5) 섬유기반 전기전자 소재·부품 및 제품 제조 기술: 전기 또는 광 신호의 생산, 저장 또는 전달이 가능한 전도성 섬유를 가공·변형하여 트랜지스터, 저항, 콘덴서, 안테나 등의 전자회로 소자를 직물 형태로 구현하는 기술

6) 의료용 섬유 제조 기술: 생체적합성(생체재료가 생체조직이나 체액·혈액 등과 접촉시 거부반응이 나타나지 않는 특성)과 생체기능성(생체재료가 체내에서 존재하는 동안 목표한 기능을 완전히 수행 가능한 특성)을 갖춘 의료용 섬유 제조 기술로서, 약물전달용 나노섬유 소재, 바이러스·세균 감응 섬유구조체, 혈액의 투석·정화용 섬유구조체, 손상조직을 대체 가능한 섬유구조체 또는 꼬이지 않고 계속되는 수축·팽창에 견딜 수 있는 인공혈관 섬유구조체의 제조 기술

7) 친환경섬유 제조 기술: 환경친화적 섬유 원료를 사용한 섬유 제조기술로서 생분해성 섬유고분자 제조 및 분해성 제어

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 기술, 열가소성 셀룰로오스 섬유 제조 기술, 바이오매스 나노섬유 제조 기술                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 8) PTFE(PolyTetraFluoro Ethylene) 멤브레인 기반 고성능 복합필터 제조기술: 공기 중의 0.3um 크기의 입자 99.97% 이상을 균일하게 포집할 수 있는 PTFE 멤브레인 기반의 고성능 복합필터 핵심 소재·부품 관련 제조·가공 기술                                                                                                                                                       |
|            | 9) 특수계면활성제 제조 기술: 전자부품 제조 공정용으로 사용되는 저표면에너지(24~27 mN/m, 0.1% solution/PGMEA), 극미량의 금속함유량(100ppb 이하) 특성을 지닌 불소계 계면활성제 및 도료 및 포소화제의 기능향상을 위한 첨가제 등으로 사용되는 저표면에너지(15~18 mN/m, 0.1% 수용액), 극미량의 PFOA 함유량(1ppm 미만) 특성을 지닌 불소계 계면활성제 제조 기술                                                                    |
| 나. 초경량 금속  | 1) 고강도 마그네슘 부품의 온간성형기술: 미세조직 구성인자의 제어와 성형기법의 개선을 통하여 저온에서 성형 가능한 고품위·고강도 Mg(마그네슘) 부품 제조 기술                                                                                                                                                                                                             |
|            | 2) 프레임 경량화 및 기능화 기술: 휴대기기 및 LCD(Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel) 등 대형 평판디스플레이에 적용하기 위하여 금속 또는 플라스틱 소재를 이용하여 압출 등의 방법으로 성형하는 소성가공을 통하여 경량화 및 미려한 표면, 오염방지, 전자파차폐 등의 기능을 갖도록 하는 생산기반 기술                                                                                                |
|            | 3) 차세대 조명용 고효율 경량 방열부품 생산기반기술: 알루미늄 등 경량소재를 이용하여 주조, 성형 및 표면처리를 통하여 방열 부품을 제조함으로써 고열전도도, 열확산능, 친환경 특성 등의 기능을 갖게 하는 기술                                                                                                                                                                                  |
| 다. 하이퍼플라스틱 | 인성특성이 향상된 고강성 하이퍼플라스틱(High Performance Plastics) 복합체 제조 및 가공 기술: 고강성 하이퍼플라스틱의 인성특성을 개선하여 고충격성(60KJ/m <sup>2</sup> 이상), 내화확성(온도 23℃의 염화칼슘 5% 용액에 600시간 침지 후 인장강도 유지율 90% 이상), 내마모성(50rpm, 150N, 측정거리 3Km 조건으로 내마모 시험 후 마모량 1.0mm <sup>3</sup> /Kgf·Km 이하) 중 하나 이상의 특성을 지닌 고강성·고인성 하이퍼플라스틱 복합체 제조 및 가공기술 |
| 라. 타이타늄    | 타이타늄 소재 제조기술과 금속재료 부품화 기술: 타이타늄 원천소재(TiCl <sub>4</sub> ), 스폰지, 잉곳, 루타일 및 아나타제 TiO <sub>2</sub> 등                                                                                                                                                                                                       |

|                   |                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 의 소재 개발·제조기술과 합금설계, 압연, 주조, 단조, 용접 등의 금속재료 부품화 기술                                                                                                             |
| 마. 구리<br>합금       | 1) 고강도 구리합금 설계·제조기술: 인장강도 900Mpa 이상의 고강도 특성을 갖춘 주석함유 구리합금(Cu-Ni-Sn계) 설계·제조 기술                                                                                 |
|                   | 2) 구리 및 구리합금 박판 제조기술: 자동차, 전기·전자 분야의 고성능·소형화에 적용 가능한 두께 0.1mm 이하의 구리 및 구리합금 박판 제조 기술                                                                          |
| 바. 몰리브덴           | 1) 고순도 몰리브덴 금속·탄화물 분말 및 금속괴 제조 기술: 순도 99.5% 이상의 몰리브덴 금속분말, 순도 99% 이상의 몰리브덴 탄화물 분말 및 순도 99.95% 이상의 몰리브덴 금속괴 제조 기술                                              |
| 사. 특수<br>강        | 1) 고청정 스테인레스계 무계목강관·봉강 제조기술: Mn 함유량 0.8% 이하 및 S 함유량 0.005%이하로 제어된 고청정 스테인리스계 합금을 활용하여 용접이음매를 갖지 않는 강관 및 봉 형태의 철강재를 제조하는 기술                                    |
|                   | 2) 고기능성 H형강 제품 제조기술: 고강도(420Mpa급 이상), 고인성(-40℃이하에서 충격값 50 Joule 이상) 특성을 갖는 고기능성 H형강 제품 제조기술                                                                   |
|                   | 3) 장수명 프리미엄급 금형소재 제조기술: 기존 교체주기 5만 회의 금형대비 30%이상 수명이 향상된 합금설계, 고청정 특수강 제조 및 소성가공 기술                                                                           |
| 아. 기능성<br>탄성·접착소재 | 1) 고기능 불소계 실리콘 제조·가공 기술: 내열성(온도 175℃에서 22시간동안 영구압축줄음을 30%이내), 내화학적성(150℃, 240시간 내유체적변화율 10%이하) 및 저온성(-66℃이하에서 기밀력 1800psi이상)의 특성을 지닌 불소계 실리콘 고무 합성 및 분자량 제어기술 |
|                   | 2) 고기능 불소계 고무 제조·가공 기술: 2원계 이상의 공중합체로서 불소함량이 50% 이상이며 내한성(어는점 -15℃이하), 내열성(200℃ 이상) 및 내화학적성(온도 25℃ Fuel-C에서 체적변화율 4% 이내)을 갖춘 불소계 고무 제조·가공 기술                  |
|                   | 3) 고기능 부타디엔 고무 제조·가공 기술: 고상 및 액상 기능성(Cis content 90% 이상, 무니점도(ML1+4, 100℃) 40 이상) 부타디엔류 고무 제조 기술과 고내마모성(내마모도 60mm <sup>3</sup> 이하, 구름저항 5.5 이하) 부타디엔 고무 제조 기술 |
|                   | 4) 고기능 비극성계 접착소재 제조기술: Haze 1% 이하의 광                                                                                                                          |

|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                 | <p>학특성과 연속사용온도 100℃의 열안정성을 갖는 실리콘계 접착·접착 소재 및 300℃ 이상의 고온가공성형이 가능한 아크릴레이트 함량 5~35% 또는 관능기의 함량 1.2~8%의 에틸렌계 접착·접착 소재 제조 기술</p> <p>5) 고기능 에폭시 수지 접착소재 제조 기술: 에폭시 수지를 주성분으로 하여 경량 수송기기 부품의 구조접착에 사용되는 전단강도 25MPa 이상, 저온 충격강도 20N/mm 이상, T-박리강도 250N/25mm 이상의 기계적 성능을 갖는 접착 소재 제조기술과 전자부품의 접착에 사용되는 WVTR 0g/m<sup>2</sup>·24h 이하 및 20kV/mm 이상의 전기절연성을 갖는 비할로젠형 접착소재 제조기술</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                 | <p>1) 고정정 환경 대응 반도체 생산 로봇 기술: 청정환경에서 450mm 대형 웨이퍼, 일반 반도체를 핸들링할 수 있는 청정 환경용 반도체 로봇 기술과 30-20 나노급 초정밀 공정용 초정밀 매니폴레이션 기술, 대형 웨이퍼 핸들링을 위한 진동 억제 기술</p> <p>2) 차세대 태양전지(Solar cell) / LED / 연료전지 제조 로봇 기술: 고진공/고청정 환경의 태양전지 생산 현장에서 대면적/박막형 태양전지를 핸들링하거나 초고효율 나노 태양전지를 핸들링하는 로봇기술과 대면적/박막형 태양전지를 핸들링하기 위한 초정밀 위치제어 기술, 초고속 웨이퍼 핸들링 매니폴레이션 기술</p> <p>3) 실내외 자율 이동·작업수행 로봇: 광범위 거리측정센서, GPS 등을 활용하여 실내외 환경에서 경로를 계획하여 이동하고(미리 정해진 경로를 따라 이동하는 방식은 제외한다), 자율적으로 작업을 수행하는 지능형 로봇 및 기계 기술</p> <p>4) FPD 이송로봇 기술: 일반 대기압 또는 진공 환경 하에서 FPD(Flat panel display)를 이송하는 로봇 기술</p> <p>5) 협동기반 차세대 제조로봇 기술: 직관적 교시기능과 충돌 방지·회피 기능을 갖추고, 다양한 작업공정에 유연하게 적응하며, 사용자와 같은 공간에서 협업이 가능한 차세대 로봇 기술</p> <p>6) 용접로봇 기술: 자동 제어 및 재프로그래밍이 가능하며 3축 이상으로 용접 작업이 가능한 로봇 설계·제조 기술</p> |
| 10. 로봇 | 가. 첨단 제조 및 산업로봇 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 나. 안전 로봇        | <p>1) 감시경계용 서비스로봇을 위한 주변환경 센싱 기술, 실내외 전천후 위치인식 및 주행 기술: 실내외에서 외부 환경을 인식하고 이를 바탕으로 감시 경계 업무를 수행하기 위하여</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 외부 환경에 강인한 센서융합, 위치인식, 환경인식 및 주행 기술 등 기술의 선택적 적용이 유연한 개방형 자율 아키텍처 기술                                                                                        |
|               | 2) 내단열 기능이 구비된 험지 돌파형 소형 구조로봇 플랫폼 기술: 고온 및 화염에 강하고 협소구역 돌파가 우수한 고속 주행 소형이동로봇 기술로서 장비 내외부 내화 설계 기술, 강제 내화시스템 설계 기술 및 험지 이동형 고속주행 메카니즘 설계 기술                  |
| 다. 의료 및 생활 로봇 | 1) 수술, 진단 및 재활 로봇기술: 로봇기술을 이용한 진단 보조, 시술·수술보조와 이에 따른 환자의 조기 치유·재활이 목적인 의료로봇 기술                                                                              |
|               | 2) 간병 및 케어 로봇 기술: 간호사의 단순반복 업무 지원 및 환자의 정서케어 서비스 지원이 가능한 로봇 서비스 시스템 기술                                                                                      |
|               | 3) 안내, 통역, 매장서비스, 홈서비스 등의 안내로봇 기술: 공공접객 장소 내에서 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 활용한 제품 및 서비스 등을 효과적으로 안내하고 홍보하는 로봇 기술                                                         |
|               | 4) Tele-presence 로봇 기술: 자율이동기능, 진단·지시용 매니퓰레이터 및 얼굴모션 동기화 등의 기술구현을 통한 원격진료·진료자문 및 교육 등이 가능한 Tele-presence 로봇 기술                                              |
|               | 5) 생활도우미 응용 서비스 기술: 가정 및 사회 환경 내에서 인간과 교감하며 정보의 취득, 일상생활 및 가사노동을 지원하는 지능형 로봇 및 서비스 기술로서 심부름, 청소, 작업보조 및 이동 보조형 로봇 기술                                        |
|               | 6) 유치원, 초등학교에서 교사를 보조하는 교육로봇 기술: 유치원이나 초등학교에서 교과과정에 적합한 교육 콘텐츠 및 로봇플랫폼을 활용하여 교사를 보조하여 학습하는 교육로봇 기술                                                          |
| 라. 로봇 공통      | 1) 실내외 소음환경에서의 대화신호 추출 기술: 잔향과 소음이 뒤섞인 실내외 환경에서 원거리에서도 고신뢰도의 음성 인식이 가능하게 하고, 음성으로부터 사람의 언어를 문자형태로 인식하고, 인식된 문자정보를 바탕으로 사람과 자연스럽게 대화하면서 다양한 태스크를 수행할 수 있는 기술 |
|               | 2) 모터, 엔코더, 드라이버 일체형의 구동 기술: 로봇용 관절 구성에 필요한 모터, 엔코더, 감속기, 드라이버를 모두 하나의 몸체에 넣어서 만든 관절구동형 액츄에이터(Actuator) 기                                                   |

|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | <p>술</p> <p>3) 웨어러블 로봇 기술: 인체에 착용하여 인체 동작의도를 인식하고 추종제어 알고리즘을 통해 착용자의 신체능력 증강 및 운동을 지원하는 착용형 로봇 기술</p>                                                                                                                                                                                                            |
| 11. 항공 · 우주 | 가. 무인 이동체 | <p>1) 무인기 지능형 자율비행 제어 시스템 기술: 무인기가 내외부의 비행 상황을 인식하고, 스스로 조종하며 임무를 수행하기 위해 필요한 비행조종컴퓨터 개발기술과 자율비행 알고리즘(algorithm) 그리고 관련 소프트웨어 기술로, 장애물 탐지 및 지상/공중 장애물 충돌회피 기술, 고장진단 및 고장허용 제어기술, 인공지능 기반 비행체 유도제어 성능향상 기술, 무인이동체 실시간 운영체제 및 소프트웨어 아키텍처 설계기술, 고신뢰성과 비행안전성 보장 경량 비행조종컴퓨터 기술을 포함하는 기술</p>                           |
|             |           | <p>2) 지능형 임무수행 기술: 무인기의 자율적인 비행과 임무수행 데이터 획득분석을 위한 기술로서 3차원 디지털 맵 생성 및 위치인식 기술, GPS 및 Non-GPS 기반의 항법기술, 무인기 교통관제 및 경로최적화 기술, 무인기 활용서비스용 데이터 처리 및 가공 기술을 포함하는 기술</p>                                                                                                                                              |
|             |           | <p>3) 무인기 탑재 첨단센서 기술: 무인기의 운항 지원과 활용 목적에 따른 임무 달성 지원을 위해 첨단 센서 및 장비를 적용하는 기술로, GPS, INS(Inertial Navigation System) 등의 항법센서기술, 소형 경량레이더 기술, 충돌회피용 소형 LIDAR(Light detection and ranging) 센서 기술, 멀티스펙트럼(multi-spectrum) 카메라 기술, 360°카메라 및 송수신 기술, Non-GNSS(Global Navigation Satellite System) 융합센서기술을 포함하는 기술</p> |
|             |           | <p>4) 무인기 전기구동 핵심부품 기술: 전기동력을 기반으로 무인기의 조종, 이착륙, 추진 등을 담당하는 핵심부품을 개발하기 위한 기술로서, 소형무인기용 고효율 전기모터 기술, 무인기용 저온용 배터리 및 전원관리시스템기술, 고효율 전기모터용 인버터(inverter) 기술을 포함하는 기술</p>                                                                                                                                            |
|             |           | <p>5) 무인기 데이터링크 핵심기술: 무인기와 지상국 · 조종기간, 무인기와 타 무인이동체 간에 감시 및 추적, 정보 전달 등의 데이터 송수신을 지속적으로 유지하기 위한 기반 기술로 소형 · 경량 탑재통신장비, 정밀 추적 안테나, 무인기간 네트워크 보안을 포함하는 기술</p>                                                                                                                                                      |
|             |           | <p>6) 무인기 지상통제 핵심기술: 무인기를 지상에서 원격으로</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                 |          |                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          | 조종하고 상황을 모니터링하기 위한 조종기, 지상국, 텔레메트리(telemetry) 장비와 관련 운영 소프트웨어 프로그램 기술로 소형무인기 조종기 개발기술, 무인기 조종훈련을 위한 시뮬레이터(simulator)기술, 실시간 무인기 상황 및 임무현황 분석기술을 포함하는 기술        |
|                 |          | 7) 물류 배송용 드론 제조기술: 일정 중량(5kg) 이상 물품을 비행을 통해 안전하게 운송 가능한 드론 및 드론-물품 장착 장치의 제조 기술 및 이와 관련한 소재·부품 및 장비의 설계·제조 기술                                                  |
|                 |          | 8) 드론용 하이브리드 추진 시스템 기술: 전기배터리 무인기의 체공시간(120분 이상) 및 탑재량(12kg 이상) 증대를 위해 엔진 동력을 이용하여 전기모터를 동작시키는 하이브리드 추진시스템 기술 및 이와 관련한 소재·부품 및 장비의 설계·제조 기술                    |
|                 | 나. 우주    | 1) 위성본체 부분품 개발기술: 위성본체 개발을 목적으로 하는 전력시스템, 자세제어용 센서 및 시스템, 위성탑재 컴퓨터시스템, 위성교신을 위한 송수신시스템, 위성 구조체 시스템(태양전지 포함), 추진시스템(추력기, 추진제 저장탱크, 밸브 및 제어기 등), 열제어시스템 등에 대한 기술 |
|                 |          | 2) 위성탑재체 부분품 개발기술: 인공위성 탑재체를 목적으로 하는 광학 탑재체, 영상레이더 탑재체, 통신·방송 탑재체, 우주과학 탑재체, 항법 탑재체 시스템 및 위성용 영상자료처리장치, 주파수 변조기 및 안테나 등에 대한 기술                                 |
|                 |          | 3) 우주발사체 부분품 개발기술: 우주발사체 개발을 목적으로 하는 액체엔진(핵심부품), 대형 구조물(추진제 탱크, 동체, 연결부, 페어링, 탑재부, 분리기구 등), 관성항법유도시스템, 자세제어시스템, 전력시스템, 원격측정·추적시스템, 비행종단시스템 등에 대한 기술            |
| 12. 첨단 소재·부품·장비 | 가. 첨단 소재 | 1) 고기능성 알루미늄 도금강판 제조 기술: 550℃에서 200시간 유지 가능한 내열성과 SST 2400(KSD9502)시간 보증 가능한 내식성이 우수한 고성능 알루미늄 도금강판 개발을 위한 조성개발, 고온성형성 향상 기술, 특수 용접기술 등의 제조기술                  |
|                 |          | 2) 고순도 산화알루미늄 제조기술: 순도 99.9% 이상의 산화알루미늄 분말 제조를 위한 합성, 가공, 고순도화, 고밀도화 등의 제조기술                                                                                   |

|             |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 나. 첨단<br>부품 | 3) 거리감지센서용 압전결정소자 및 초음파 트랜스듀서 기술:<br>거리감지센서 등에 사용되는 압전결정소자 및 초음파 트랜스듀서 설계·제조기술                                                                                     |
|             | 4) 고기능성 인조흑연 제조기술: 인조흑연 제조용 피치 및 코크스 제조 기술, 전극봉·등방블록·흑연분말 성형 및 2,800℃ 이상의 열처리를 통한 흑연화 기술                                                                           |
|             | 1) 고정밀 롤러베어링 및 볼베어링 설계·제조 기술: 구름베어링의 일종으로 내외륜 사이에 다수의 볼 또는 롤러를 삽입하여 마찰을 감소시켜 고속운전을 돕거나 큰 하중에 견딜 수 있는 정밀도 P5급 이상의 기계부품 설계·제조 기술                                     |
|             | 2) 고압 컨트롤 밸브 설계·제조 기술: 유압펌프에서 발생한 330 Bar 이상 고압의 유체에너지를 작업자의 작업의도에 따라 각 유압 액추에이터, 선회 및 주행의 유압모터 등에 공급하며, B5 10,000시간 이상의 높은 내구 신뢰성을 가지는 메인 컨트롤 밸브 부품 설계·제조 기술      |
|             | 3) 고정밀 볼스크류 설계·제조기술: 회전운동을 직선운동으로 변환하는 정밀도 C3급 이상, 축방향 공차 5 $\mu$ m 이내의 동력전달부품 설계·제조 기술                                                                            |
|             | 4) 능동마그네틱 베어링 설계·제조기술: 자력을 이용하여 회전축을 지지하고, 윤활제가 필요 없이 극저온(-250℃ 내외) 또는 고온(300℃ 이상), 진공에서 축의 회전 궤적을 능동적으로 제어할 수 있는 부품 설계·제조 기술                                      |
|             | 5) 고성능 터보식 펌프 설계·제조기술: 임펠러 및 블레이드가 회전함으로써 기계의 운동에너지를 유체·기체의 압력에너지로 전환하여 2,500L/s 이상의 배기속도 및 1.3x10 <sup>-9</sup> mbar 이상의 최고 진공도를 만드는 터보식 펌프의 설계·제조기술              |
|             | 6) 특수 렌즈 소재·부품·장비 제조기술: 고배율[굴절률(nd) 2.0 이상], 야간 투시[원적외선(파장 8~12 $\mu$ m) 투과율 50% 이상], 자외선투과[자외광(193nm) 투과율 80% 이상] 등 특수용도로 사용되는 카메라 구성에 필요한 특수 광학소재의 소재·부품·장비 제조기술 |
|             | 7) 고기능 적층세라믹콘덴서(MLCC: Multi Layer Ceramic Capacitor) 소재·부품 제조기술: 고용량, 고신뢰성을 갖춘 적층세라믹컨덴서의 소재·부품 제조기술 소재·부품·장비 제조기술                                                  |
|             | 8) 선박용 모터(Motor): 각종 펌프(Pump), 압축기, 엔진(Engine) 시동장치, 크레인(Crane), 팬(Pan) 등 일반선박용                                                                                    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>모터의 소재·부품 및 액화천연가스(LNG, Liquefied Natural Gas) 추진선박, 가스(Gas) 운반선, 유조선, 화학물 취급선 등 특수선박용 방폭형 모터와 전기 추진선박, 수소 연료전지 선박 등 전기추진용 모터의 핵심 소재·부품을 설계·제작·시험·평가하는 기술</p>                                                                                                                                 |
| 다. 첨단 장비 | <p>1) 첨단 머시닝센터 설계·제조기술: 자동공구교환장치(Automatic Tool Changer)를 장착하여, 밀링, 드릴링, 보링 가공 등 여러 공정의 작업을 수행할 수 있는 가공정밀도 5<math>\mu</math>m 이내, 동시 제어 5축 이상, 최대 스핀들 속도 12,000rpm 이상의 절삭가공장비 및 부품의 설계·제조 기술(가공 회전수, 축 이동, 진동오차 제어 등 머시닝센터의 고정밀 작업을 제어하는 CNC(Computerized Numerical Controller) 모듈 관련 기술 포함)</p> |
|          | <p>2) 열간 등방압 정수압 프레스 설계·제조 기술: 기체 또는 액체를 압력매체로 활용하여 1,500℃이상에서 작동하면서 1분당 최고 50℃의 속도로 냉각이 가능하고, 금속 소재를 모든 방향에서 100MPa 이상의 정수압 또는 등방압 조건으로 가압하는 직경 1,000mm 이상의 프레스 장비 설계·제조 기술</p>                                                                                                                 |
|          | <p>3) 연삭가공기 설계·제조 기술: 사파이어, 다이아몬드 등 고정도의 광물입자를 결합제로 고정시킨 슷돌을 이용하여 평면·원통 등 단순한 형태가 아닌 복잡한 형태의 가공공정을 수행하는 장비 설계·제조 기술</p>                                                                                                                                                                          |
|          | <p>4) 첨단 터닝센터: 원통형 부품의 가공을 위해 소재를 회전시키면서 절삭 공구가 상대 이동하는 가공정밀도 5<math>\mu</math>m 이내, 최대 스핀들 속도 3,000rpm 이상의 절삭가공장비 설계·제조 기술(ISO 7등급 이하의 기어 제조를 위한 고속 스카이빙 가공장비 관련 기술 포함)</p>                                                                                                                     |
|          | <p>5) 첨단 회전 성형기 설계·제조 기술: 다축 정밀 동시제어시스템을 갖추고, 회전하는 주축과 롤러, 맨드릴을 이용하여 최대 성형률 하중 60kN 이상, 최대 성형품 직경 500mm 이상, 성형 정밀도 <math>\pm 0.5</math>mm를 충족하는 성형 장비 설계·제조 기술</p>                                                                                                                               |
|          | <p>6) 첨단 밸런싱머신 설계·제조기술: 회전기계의 핵심부품인 회전부의 불균일한 질량분포를 측정후, 베어링으로 전달되는 힘이나 진동을 국제규격(ISO 21940-21) 규정 이내가</p>                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 되도록 불균일 질량을 교정하는 장비 설계·제조 기술                                                                                   |
|  | 7) 첨단 레이저 가공장비 설계·제조기술: 절단, 천공, 용접, 정밀가공 등을 위해 고출력 레이저 가공헤드로 공작물을 용융·증발시켜서 분리하는 5축 이상의 레이저 가공장비를 설계·제조하는 기술    |
|  | 8) 방전가공기 장비·부품의 설계·제조기술: 공작물과 전극 사이에 불꽃 방전을 일으켜 티타늄, 초경합금 등 난삭재의 마이크로급 초정밀 가공을 수행하는 방전가공 장비 및 핵심 요소부품의 설계·제조기술 |